

## 第 35 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム 2025 (MES2025) の開催にあたって



一般社団法人エレクトロニクス実装学会  
MES2025 組織委員長  
大阪大学 接合科学研究所  
西川 宏

MES (マイクロエレクトロニクスシンポジウム) が 9 月 3 日 (水)～5 日 (金) の 3 日間、大阪大学中之島センターにて開催されます。

今回の特別講演には、産業界からインテル株式会社の大野誠様、学术界から大阪大学の森勇介先生の著名なお二方をお招きすることができました。半導体業界をそれぞれの形で牽引されているお二方のご講演を通して、半導体材料や半導体技術の進化、AI や IoT との融合、その先にある未来社会を語り合える機会にしたいと考えております。

インテル株式会社の大野誠様には『2030 年に向けた半導体未来シナリオ』と題して半導体や AI、量子コンピューターの進化、将来の可能性について展望いただきます。世界中に拠点をもつグローバル企業の視点や、設計から製造までを一貫して担う半導体企業の視点など、様々な視点を包含した半導体未来シナリオをご披露いただけるものと期待しております。

大阪大学の森勇介先生には『産業の川上「結晶」が拓くグリーン・デジタル社会』と題して半導体「結晶」の進化が半導体産業全体に与えるインパクトと、そこから拓かれる社会についてご講演いただきます。紫外線を発生する新たな結晶の発見や GaN 結晶育成技術の創出などの研究成果にとどまらず、複数のベンチャー企業の設立、心理学的アプローチを取り入れた教育などにも精力的に取り組まれており、独創的な視点で半導体材料から未来社会までをお話いただけるものと期待しております。

一方、一般講演では、先端プロセス・実装技術、光回路実装技術、パワーエレクトロニクス実装技術、マイクロメカトロニクス実装技術、プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス、環境調和型エレクトロニクス、最先端材料、信頼性技術、めっき技術、高速高周波実装・電磁特性技術の各セッションに計 62 件の口頭発表があり、更に 2 件の依頼講演、8 件の第 39 回春季講演大会受賞講演、21 件のポスター発表、17 社の企業展示があります。また、9 月 3 日の特別セッションでは「JEITA 2024 年度実装技術ロードマップ」、特別企画セッション「ガラスコアサブストレート」、「若手大活躍推進セッション」が企画されており、半導体業界やエレクトロニクス実装技術の最新動向など幅広い講演やパネルディスカッションが準備されており、大変興味深い内容となっております。今回もハイブリッド開催いたしますが、是非、多くの皆様に会場までお越し頂き、現地で議論、交流して頂ければと思います。

現在、大阪では、大阪・関西万博が開催されております。万博は地球規模の様々な課題に取り組むために世界中から英知が集まる場であり、未来社会の実験場ともいえるイベントです。カーボンニュートラル、デジタル技術、次世代モビリティなど、エレクトロニクス実装が深く関わる分野も多く、私たちの技術が社会課題解決にどのように貢献できるかを改めて考える絶好の機会ですので、是非、MES の前後には大阪・関西万博にも足を運んで頂ければと思います。

多くの皆様に会場までお越し頂き、多くの知見と議論、情熱が交差することで、次の時代を見据えたイノベーションが生まれることを心から願っております。活発な議論を通じて日本のエレクトロニクス実装技術の未来をともに描いてまいりましょう。

最後に、本シンポジウムの開催にご協力・ご支援いただきました関係各位に深く感謝申し上げます。